

台灣發明協會 函

地址：241608新北市三重區重陽路一段1號
4樓之11

承辦人：秘書處 吳秋瑾

電話：02-66057626

電子信箱：tia7626@yahoo.com.tw

受文者：東海大學

發文日期：中華民國115年7月29日

發文字號：台發協字第1150007004號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：2026香港亞洲創新發明展覽會簡章1.邀請函2.報名表3.切結書
(0007004A00_ATTCH5.pdf、0007004A00_ATTCH6.docx、0007004A00_ATTCH7.pdf)

主旨：敬邀 貴校參加「2026第6屆香港亞洲創新發明展覽會
AEII」，請協助轉知師生踴躍報名參加。

說明：

一、「2026第6屆香港亞洲創新發明展覽會AEII」為

Inventions Geneva - Asia Station日內瓦發明展-亞洲
站，由 Palexpo（日內瓦國際發明展主辦方）與香港合作
舉辦，活動同時結合香港貿發局創業日（E-Day）及亞洲知
識產權營商論壇（BIP Asia Forum），促進思想交流與跨
界合作，創造無限商機，再度成為亞洲創新與發明的焦
點。敬邀貴校師生參與，請惠予公告並鼓勵師生踴躍參
加，以提倡發明創新風氣，並為國爭取最高榮譽。

二、參展日期、地點：2026年11月19日至20日，香港會議展覽
中心，共為期2天。

三、即日起報名至2026年10月10日截止。（參賽簡章請參考附
件）

東海大學

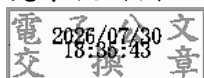


1150009940 115/07/31

四、報名相關問題歡迎洽詢本會承辦人：秘書處 吳秋瑾 小姐。電話：(02)6605-7626。電子郵件：tia7626@yahoo.com.tw。亦歡迎透過LINE官方好友：@tia1972 與我們聯繫。

正本：國立臺灣海洋大學、國立政治大學、國立臺灣大學、國立臺灣大學計算機及資訊網路中心、國立臺灣師範大學、國立陽明交通大學、國立臺北藝術大學、國立臺北教育大學、臺北市立大學、東吳大學、中國文化大學、世新大學、銘傳大學、實踐大學、大同大學、臺北醫學大學、康寧學校財團法人康寧大學、國立臺灣戲曲學院、國立臺北護理健康大學、國立臺北商業大學、國立臺北大學、國立臺灣藝術大學、輔仁大學學校財團法人輔仁大學、淡江大學學校財團法人淡江大學、真理大學、國立體育大學、國立中央大學、中原大學、長庚大學、元智大學、開南大學、國立清華大學、玄奘大學、中華大學學校財團法人中華大學、國立聯合大學、國立臺中教育大學、國立臺灣體育運動大學、國立中興大學、國立中興大學計算機及資訊網路中心、東海大學、逢甲大學、靜宜大學、中山醫學大學、亞洲大學、國立彰化師範大學、大葉大學、明道學校財團法人明道大學、建國科技大學、國立暨南國際大學、國立嘉義大學、國立中正大學、南華大學、國立臺南藝術大學、國立臺南大學、台灣首府學校財團法人台灣首府大學、中信學校財團法人中信金融管理學院、長榮大學、國立中山大學、國立高雄師範大學、國立高雄大學、義守大學、高雄醫學大學、國立屏東大學、國立金門大學、國立宜蘭大學、佛光大學、國立東華大學、慈濟學校財團法人慈濟大學、國立臺東大學、國立空中大學、高雄市立空中大學、國立嘉義大學附設實驗國民小學、恩慈美國學校、新竹美國學校、桃園美國學校、國立成功大學、中華台北著作權人協會、華梵學校財團法人華梵大學

副本：



台灣發明協會 理事長 張家菊